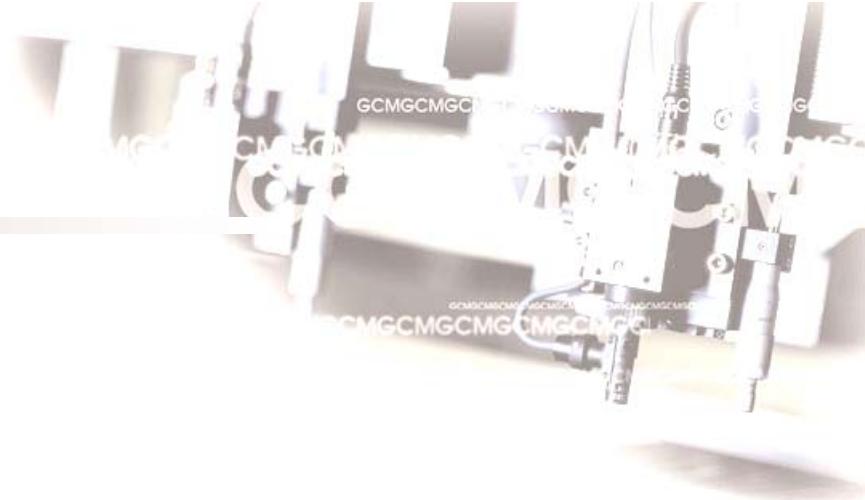


# 2010年2月期第2四半期決算会社説明会資料



# 2009年10月20日

## RORZE CORPORATION



# 2010年2月期第2四半期 決算概要

# 2010年2月期第2四半期(累計) 連結損益計算書

(百万円)

	2009年2月期 第2四半期(累計) 実績	2010年2月期 第2四半期(累計) 実績	増減率	増減理由等
売上高	5,765	902	△84.4%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・世界的な半導体や液晶関連の設備投資減少</li> <li>・特に、日本のウエハ搬送装置、並びに韓国ガラス基板搬送装置の受注が低調に推移</li> </ul>
売上総利益	1,370	0	△100.0%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当社、並びに韓国子会社の減収と、それに伴うベトナム生産子会社の生産量低下 等</li> </ul>
販管費	1,030	687	△33.3%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定費削減</li> <li>・減収に伴う販売関連費用(旅費・販促費等)の減少</li> </ul>
営業利益又は 営業損失(△)	339	△687	—%	
経常利益又は 経常損失(△)	256	△582	—%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
四半期純利益又は 四半期純損失(△)	35	△369	—%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

# 2010年2月期第2四半期 連結貸借対照表

GCMGCMGC

(百万円)

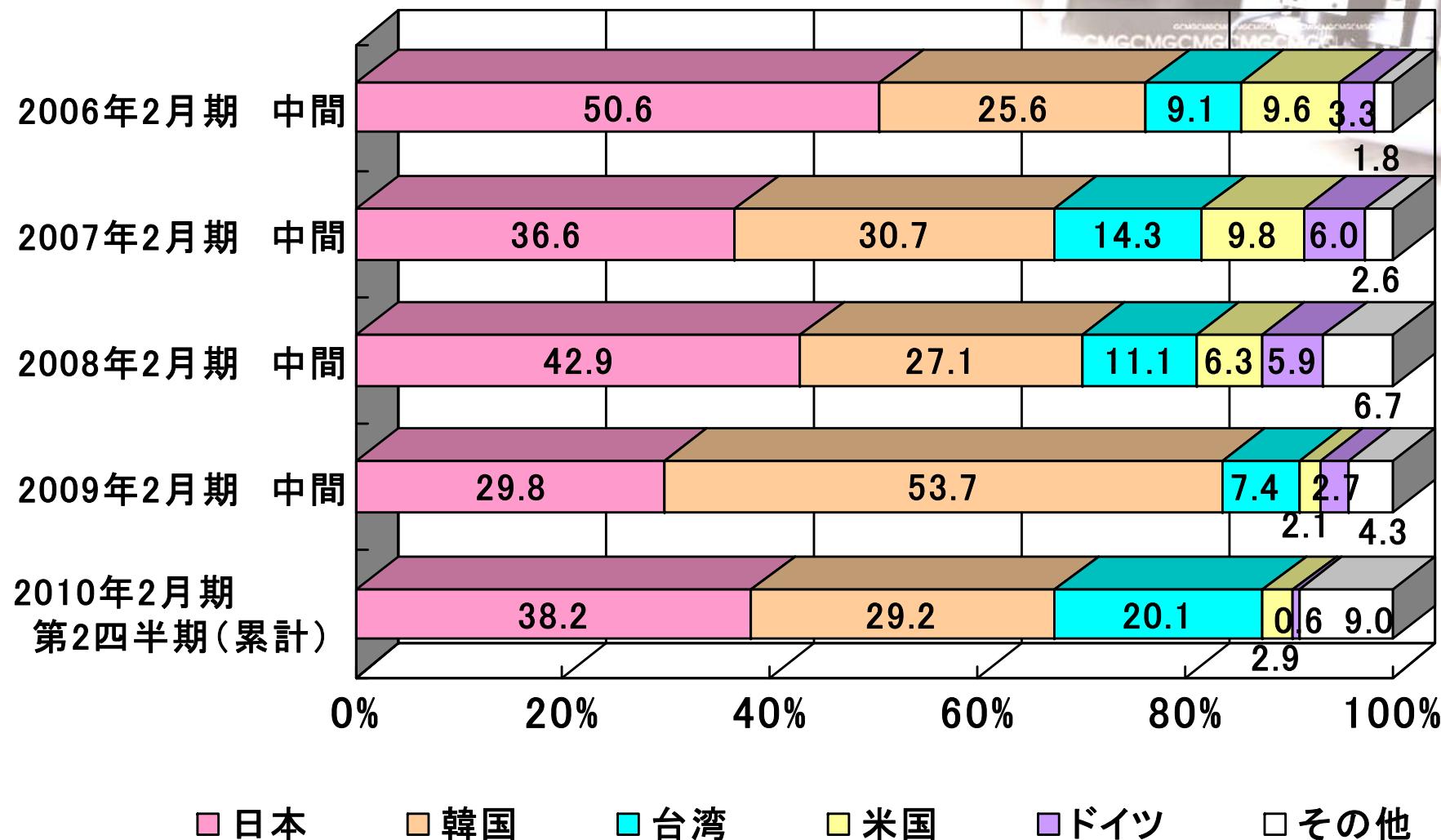
	2009年2月期 第2四半期実績	2010年2月期 第2四半期実績	増減額	増減理由等
流動資産	10,788	6,891	△3,897	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現金及び預金 △191</li> <li>・受取手形及び売掛金 △2,828</li> <li>・仕掛品 △351</li> <li>・原材料及び貯蔵品 △400</li> <li>・その他 △107</li> </ul>
固定資産	7,549	6,692	△857	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物及び構築物 △375</li> <li>・土地 △129</li> <li>・その他(有形固定資産) △461</li> <li>・繰延税金資産 +198</li> </ul>
繰延資産	143	—	△143	・開発費 △143
資産合計	18,481	13,583	△4,898	
流動負債	6,631	4,464	△2,167	<ul style="list-style-type: none"> <li>・支払手形及び買掛金 △903</li> <li>・短期借入金 △707</li> <li>・未払法人税等 △143</li> <li>・製品保証引当金 △216</li> <li>・その他 △155</li> </ul>
固定負債	2,330	1,497	△832	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期借入金 △582</li> <li>・繰延税金負債 △177</li> </ul>
負債合計	8,961	5,961	△2,999	
株主資本	8,284	7,656	△628	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利益剰余金 △525</li> <li>・自己株式 △102</li> </ul>
評価・換算差額等	△233	△1,054	△820	・為替換算調整勘定 △777
新株予約権	—	2	2	・新株予約権 +2
少数株主持分	1,468	1,016	△452	・少数株主持分(主に韓国子会社) △452
純資産合計	9,519	7,621	△1,898	
負債純資産合計	18,481	13,583	△4,898	

# 2010年2月期第2四半期(累計) 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2009年2月期 第2四半期(累計) 実績	2010年2月期 第2四半期(累計) 実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	209	49	△160
投資活動による キャッシュ・フロー	62	241	179
財務活動による キャッシュ・フロー	△574	△948	△374
現金及び現金同等物 に係る換算差額	△99	51	151
現金及び現金同等物 の増減額	△402	△606	△204
現金及び現金同等物 の期首残高	2,086	2,359	272
現金及び現金同等物 の期末残高	1,684	1,752	68

# 海外売上高(連結)



■ 日本

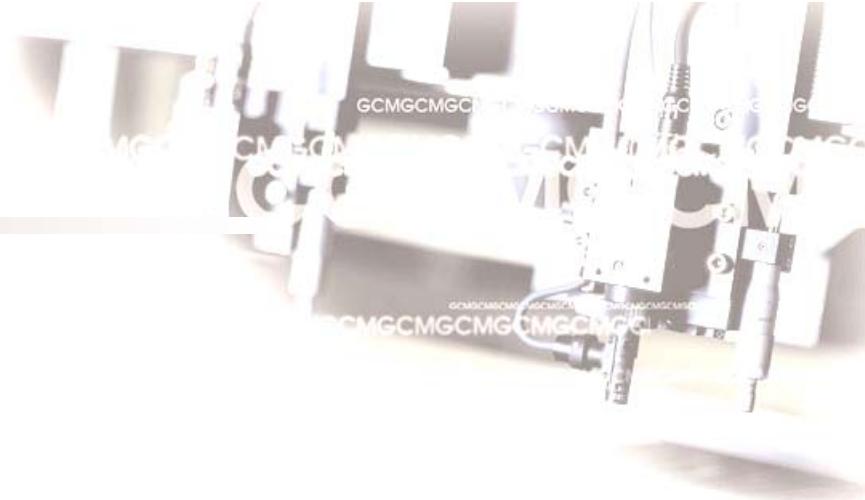
□ 韓国

■ 台湾

□ 米国

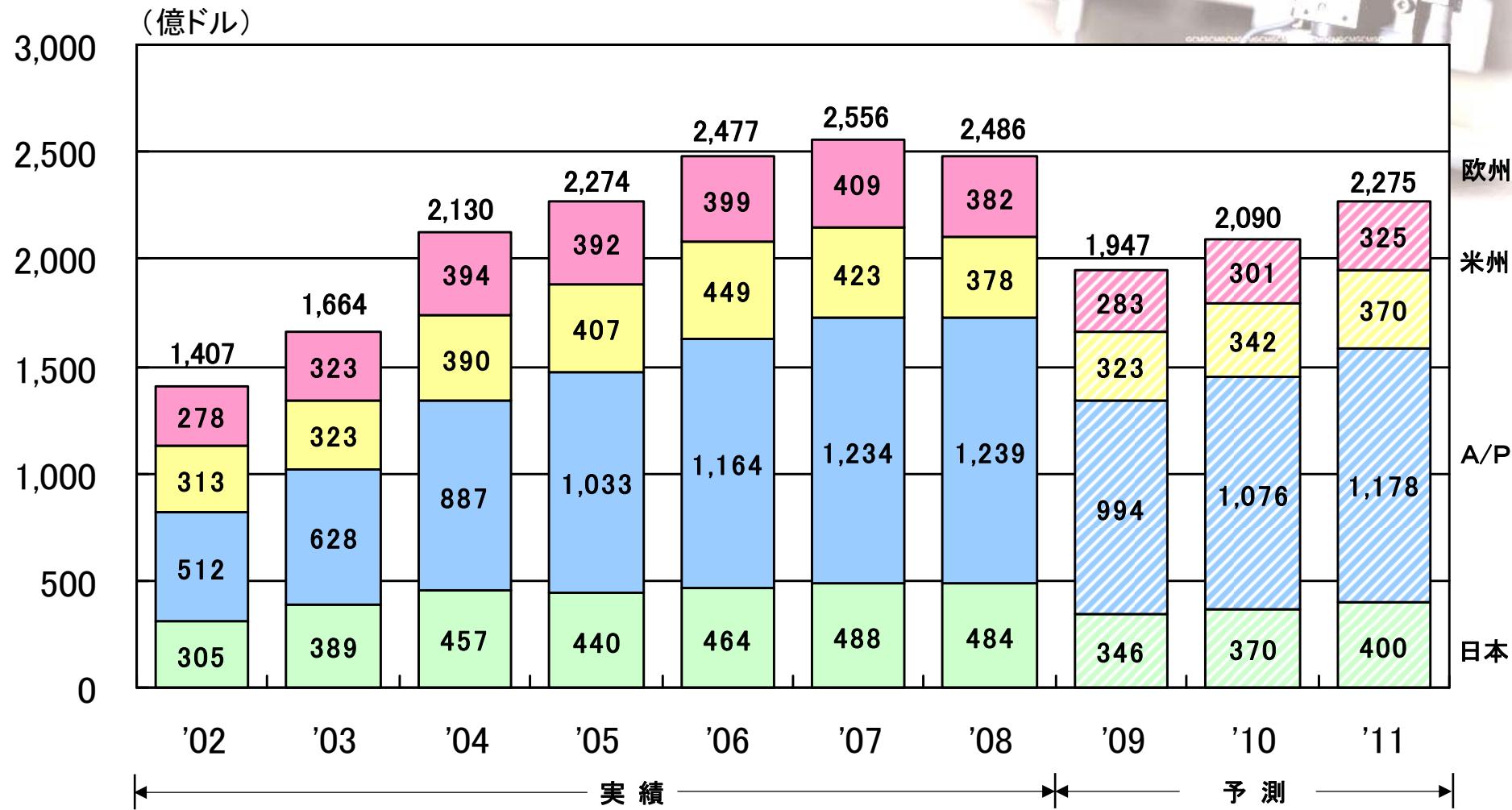
■ ドイツ

□ その他



# 2010年2月期 通期連結業績予想

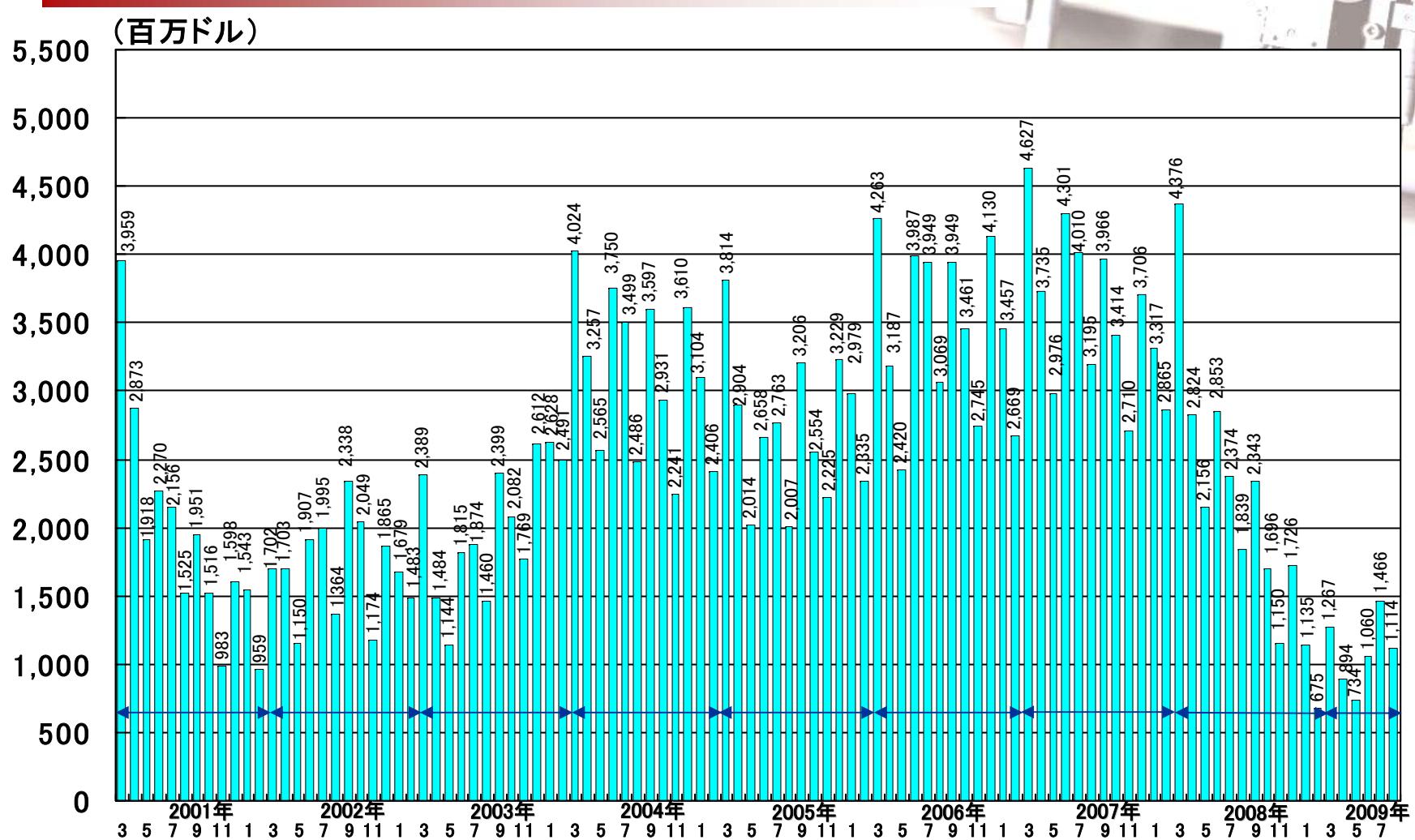
# 世界の地域別半導体市場規模



注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2009年7月15日付 半導体産業新聞) (2009年6月 WSTS発表)

# 世界規模 半導体製造装置販売統計 (2009年8月末現在)



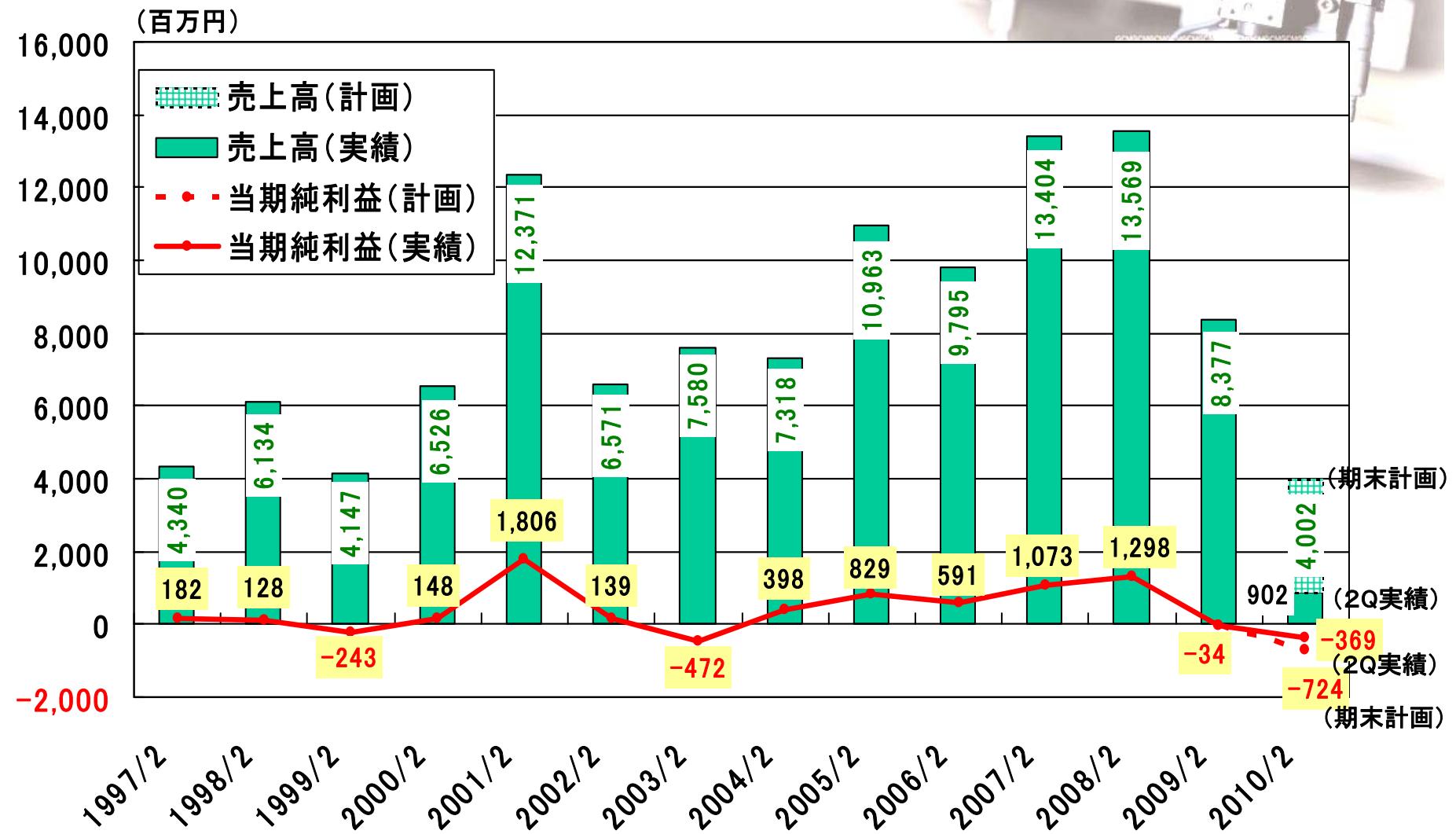
(出所 : S E A J, S E M I, S E M I ジャパン)

# 2010年2月期 通期連結業績予想

(百万円)

	2009年2月期 通期実績	2010年2月期 第2四半期(累計) 実績	2010年2月期 通期予想
売上高	8,377	902	4,002
売上総利益	1,836	0	275
販管費	1,681	687	1,419
営業利益又は 営業損失(△)	154	△687	△1,144
経常利益又は 経常損失(△)	152	△582	△1,104
当期(四半期) 純損失(△)	△34	△369	△724

# 連結業績の推移





# ありがとうございました！

## 注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点での把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。